

ご挨拶

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、2027年3月期までの中期経営計画にて、既存事業のオーガニックな成長に加え新たな事業を追加し事業拡大を実現させることで、「1兆円規模の『エレクトロニクスの情報プラットフォーマー』」を目指す姿として掲げ、長期的な成長に向けて取り組んでおります。

会長兼社長を担ってきた今野 邦廣が代表取締役 会長CEOとして経営全般の責任を担い、グループ全体を牽引するとともに、代表取締役 社長COOを担う林 眞一が既存事業の一層の成長と深化を推進する経営体制といたします。また、システムビジネスユニット(BU)統括の今野 宏晃、デバイスBU統括の柴田 真裕、コーポレートヘッドオフィス統括の二島進、人事・組織改革統括の戸川 清の4名が社内の取締役として、それぞれの管掌領域に執行と経営責任を持ち、迅速な意思決定を行う経営体制といたしました。新たな経営体制において、今後の事業拡大と更なる成長を目指してまいります。

今後ともお取引先の皆様とともに様々な社会課題の解決に取り組むことによって、ステークホルダーの皆様との信頼 関係をさらに高め、サステナブルな社会の発展に努めてまいります。引き続きご支援ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

> 株式会社レスター 代表取締役 会長CEO 今野 邦廣 代表取締役 社長COO 林 眞一

■ 経営理念

Mission ミッション 情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、 社会の発展に貢献します

Vision ビジョン あらゆるニーズに対応できる 「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指します 世界・社会貢献・共創と革新

Values バリュー

多様な考えを受け入れ、共創を通じて、新しい文化や価値を創り出します 常に高い目標を掲げて、革新的な発想と情熱で、挑戦し続けます 活躍の場を世界へと広げ、持続可能な社会の発展に貢献します

基本方針

目指す姿

お客様のすべての課題をエレクトロニクスで解決する 1兆円規模の「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」

1 既存事業の成長

パートナーシップによる バリューチェーンの強靭化 と収益力強化

2 事業領域の拡大

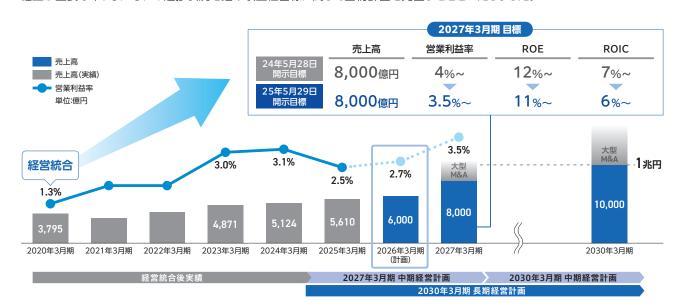
"エンジニアリング"と "IT&Sler"の事業化

3 事業シナジーの追求

あらゆる 商材・情報・技術を繋ぐ プラットフォームの構築

■ 中期経営計画の見直し

当社が目指す収益構造の改革には、既存のデバイスBU、システムBUに加え、IT&SIerBUの規模拡大とエンジニアリングBUの確立が重要な中、それぞれの進捗状況を鑑み収益性目標に関して当初計画を見直すことといたしました。



グローバル

FPT Semiconductor社と協力関係の推進 ~日越首相の前でMOU調印式~



2025年4月28日に、FPT Semiconductor.,JSC(本社:ベトナム ハノイ、Founder & CEO:グエン・ビン・クアン(Nguyen Vinh Quang)、以下、FPT)と、半導体分野における協業推進に向けた基本合意書(MOU)を締結しました。 ハノイにて同日開催された日 越首脳会談の後に、「ハイテク・GX(グリーン・トランスフォーメーション)・半導体分野における高付加価値産業創出に向けた日越協力 フォーラムlが開催されました。当フォーラムの中でMOU調印式として当社とFPTそれぞれの代表が登壇し、栄誉ある称賛を両国首 相はじめ列席者からも得ることとなり、レスターとFPTの"共創"が国際的にも高く評価される機会となりました。

主な協力内容

デバイスBU

01

半導体チップ の販売

販売目標: 1,000万個 (FY25-FY27)

02

半導体の 共同研究・設計開発

エンジニアリングBU 03

半導体のテスト OSAT*事業

*OSAT:後工程サービス

04

オフショア開発 の推進



デバイスBUとの連携

当社顧客基盤を 活かした拡販

エンジニアリングBU確立に向けて

- PCIホールディングス株式会社の子会社で、電子回路・制御ソフトウェア開発や半導体テスト関連 サービスを行う株式会社プリバテックと連携、半導体の共同研究、設計開発を強化
- ② 当社の半導体信頼性評価センター (態本拠点) やFPTとの協力による信頼性試験などの半導体テストの強化



【日越協力フォーラムMOU調印式の様子(左から、石破首相、当社取締役 常務執行役員 柴田 真裕、 FPT Semiconductor...JSC Founder&CEO Quang氏、ベトナムChinh首相)】

デバイスBU

パートナー連携における進捗状況について

合弁会社設立や業務提携等によるパートナーとの連携強化により拡販を図っています。

01

デクセリアルズ(株)との パートナーシップ形成

Dexerials共創
FY25計画(売上高)
300億円超

A) 戦略的パートナーシップの形成

・ケミカル商材のラインカード拡充及びマーケ ティング強化

B) 当社連結子会社としての 販売オペレーション開始

- ・Restar Dexerials Hong Kong Limited(2024年7月1日)
- ・Restar Dexerials Korea Corporation(2025年1月2日)
- ・Restar Dexerials Taiwan Corporation(2025年2月3日)

C) 合弁会社の設立

・ アジアでの拡販 北米(デトロイト)を拠点とした車載関連ビジネスの拡大 02

WPGグループとの 連携強化

WPG共創

パートナー連携による 取り扱い商材の拡大 及び 規模拡大

A) 顧客基盤の活用

- ・当社製品の海外拡販及びWPG製品 の日本国内販売
- ・クロスセルによる事業拡大

B) 他BUとの連携

C) マーケティング強化による事業創造

03

新光商事㈱との 業務提携による拡販

クロスセルによる FY25からの 業績寄与

A) 業務資本提携を活かした共創協業

- ・両社の顧客基盤を活用した市場拡大と 付加価値提供
- ・注力領域である産機市場への拡販

B) クロスセルによる既存事業の深耕

・両社の顧客基盤を活かしたクロスセル の拡大

◆ 財務戦略・資金調達の多様化

当社の成長戦略を実現するため、財務規律を意識しながら様々な資金調達を以下の通り行っております。

劣後特約付ローンの活用



劣後特約付ローンにより 100億円の資金調達

2024年5月付で劣後特約付ローンによる資金調達(総額100億円)を行いました。本ローンは、格付機関(株式会社日本格付研究所)から借入額に対して50%の資本性の認定を受けています。更なる成長に向けて戦略的な資金調達を今後も進めてまいります。

九州・沖縄地銀連携協定参加地銀からの資金調達



地方銀行連携シンジケートローンで総額66億円を資金調達

2025年2月付で株式会社肥後銀行をアレンジャーとする九州・沖縄連携協定[Q-BASS(キューベース)]参加地銀から総額66億円の資金調達を実施しました。

本件はシンジケートローン組成の第一 号案件となります。半導体産業の集積 や他産業の強化を通じた地域創生に 活用し、地域経済の活性化を図ります。

無担保社債の発行



財務基盤強化を目的に 第1回社債100億円を発行

2025年3月付で100億円の第1回無 担保普通社債(3年債)を発行しました。利率は年2.145%で、償還期限は 2028年3月21日です。

この社債発行は、資金調達手段の多様 化と財務安定性の向上を目的としており、調達資金は既存借入金の返済に充 当予定です。

◆ サステナビリティデータブック発刊





ESG取り組みの基本方針やKPIを 一冊に集約して紹介



2025年3月に初となる「サステナビリティデータブック」を発刊いたしました。全24ページにわたり、当社のサステナビリティに関する基本方針に加え、環境・社会・ガバナンス(ESG)の主な取り組みや関連データについて掲載しています。本冊子を通じて、当社のサステナビリティに関する取り組みに対するご理解とご関心を深めていただければ幸いです。

過去最高の売上高と営業利益を達成

M&Aや合弁会社設立による連結子会社化に伴う増収、また、デバイス事業における高機能カメラやモバイル機器を中心とした民生向け売上の伸長、さらにはスマートフォン新機種への搭載効果によるEMS事業の業績改善などにより売上高は昨年度に続き過去最高





- ※ デバイスBU ・連結子会社化が寄与したことや民生向け売上の伸長により増収、セグメント利益は、デバイス事業における急激な円高の影響による売上総利益の悪化や、産業機器市場の回復の遅れによる販売ミックスの悪化に伴う売上総利益率の低下などにより減益
- ✓ IT&Sler BU · PCIグループを連結子会社として以降、サービス商品化を目的とした技術の棚卸を実施、両グループ内での活用可能なサービス・商品を選定するなど、それぞれの顧客基盤を活かした新たな案件や領域に向けた販売活動を推進

セグメント別業績ハイライト

(百万円)

	2024年3月期		2025年3月期			
	売上高	セグメント利益	売上高	増減率	セグメント利益	増減率
デバイスBU	471,900	12,479	505,085	7.0%	11,205	10.2%╃
システムBU	40,583	5,344	42,835	5.5%	4,205	21.3%₹
IT&Sler BU	_	_	13,079	_	468	_
連結業績	512,484	15,931	561,001	9.5%	14,174	11.0%

[※]前期比の◆は増加、◆は減少の意味です。

株主還元方針 (2025年3月期~2027年3月期)

- ·安定的な株主還元の充実、成長領域への積極的な投資と財務健 全性のバランスを考慮
- · 連結株主資本配当率 (DOE*) 4%以上
- ・安定的且つ継続的に増配を実施
- ・余剰資金については機動的な自社株買い

1株当たり配当金

(円)



^{*}DOE (Dividend on Equity): 株主資本配当率=配当額÷株主資本 = 配当利回×PBR

会社情報

会社概要 (2025年3月31日現在)

社名 株式会社レスター

本社所在地 東京都港区港南二丁目10番9号 レスタービルディング

営業開始日2019年4月1日資本金43億83百万円

従業員数 連結 4,483名 単体 1,021名

役員 (2025年6月27日現在)

代表取締役 会長 CEO 今 野 邦 廣 取締役(社外) 尹 晋 赫代表取締役 社長 COO 林 眞 一 取締役監査等委員 鈴 木 俊 幸取締役 専務執行役員 今 野 宏 晃 取締役監査等委員(社外) 手 塚 仙 夫取締役 執行役員 二 島 進 取締役監査等委員(社外) 伊 達 玲 子取締役 執行役員 戸 川 清 取締役監査等委員(社外) 笠野さち子

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

剰余金の配当の 期末配当:毎年3月31日

基準日 ※中間配当を実施するときの基準日は9月30日

定時株主総会 毎年6月開催

公告方法 電子公告により行います。

公告掲載URL https://www.restargp.com/

ir/other/

ただし、電子公告によることができない事故その他 やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に

掲載いたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

(連絡先) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

東京都府中市日鋼町1-1

TEL 0120-232-711 (通話料無料) 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

郵便物送付先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株式の状況 (2025年3月31日現在)

①発行可能株式総数 57,000,000株

②発行済株式の総数 30,072,643株 ※上記には自己株式1.954.690株が含まれております。

3株主数 9.759名

大株主の状況(上位10名)

株主名	株式数 (千株)	持株比率(%)
株式会社ケイエムエフ	6,480	23.04
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニーグループロ 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	2,951	10.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,339	8.32
SBIホールディングス株式会社	1,000	3.55
株式会社三菱UFJ銀行	818	2.91
レスター従業員持株会	724	2.57
株式会社みずほ銀行	692	2.46
新光商事株式会社	550	1.95
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	548	1.95
キヤノン電子株式会社	404	1.43

※当社は自己株式1,954,690株を保有しております。 ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。

最新情報は当社Webサイトをご覧下さい

当社Webサイトでは、当社をよりご理解いただけるよう、経営理念や事業内容に加え、広報・IR、サステナビリティ関連・ESG/SDGsや各種ニュースなど、様々な情報を掲載しております。ぜひ一度ご覧下さい。

https://www.restargp.com/

株式会社レスター

検索









